

Hydrogen Plasma Treatment Effect on the Formation of Intrinsic Silicon of HIT Solar Cell

劉俊岑、薛英家

E-mail: 9419810@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

In this thesis, the intrinsic layer of HIT solar cell is studied. The formation of intrinsic layer is made by using hydrogen plasma treatment on the surface of silicon wafer. A systematic study on hydrogen plasma effecting upon device is undertaken, and the performance of solar cells is measured. The complex preparation processes of HIT solar cell are described in which including texturing, cleaning, back side electrode screen printing, oxide removing, hydrogen plasma treating (intrinsic layer formation), n-type amorphous silicon depositing, ITO coating, and front side aluminum electrode coating. It is proved that hydrogen plasma treatment has significant improvement on the conversion efficiency of solar cell. Tacuchi Method is used to obtain the optimal combination of process parameters of hydrogen flow rate, chamber pressure, RF power, and process time. For a sequence of 3 Tacuchi experiments, the conversion efficiency is escalated from 5.8%, up to 6.63% and finally reaching 7.01%.

Keywords : HIT solar cell words

Table of Contents

封面內頁 簽名頁 授權書

iv 英文摘要

vi 目錄

ix 表目錄

一章 緒論

3 2.2 太陽電池的原理

4 2.4 表面粗化/纖質化 (Texture)

9 2.6 氢氣電漿與非晶矽成膜

15 第三章 實驗步驟與結果討論 3.1 表面粗化實驗

22 3.3 n-type非晶矽

29 3.5 濺鍍製作能導電的抗反射膜

45 第四章 總結

55 參考文獻

表面構造

示意圖

件各層因高溫擴散導致界面破壞示意圖

圖9. PECVD沉積薄膜原理示意圖

14 圖11. 表面粗化實驗製作流程圖

19 圖13. 經過蝕刻的晶片在光學顯微鏡下觀察的結果

22 圖15. 刮刀調整示意圖

24 圖17. PH3流量與電導值關係圖

圖

27 圖19. 功率與電導值關係圖

刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM 5k倍觀察金字塔照片

過SF6蝕刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM 50k倍觀察金字塔之間照片

圖20-3. 未經過SF6蝕刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM 100k倍觀察金字塔照片

31 圖21-1. (a) 經過SF6蝕刻的矽晶片在SEM 5k倍觀察金字塔照片

32 圖21-1. (b) 經過SF6蝕刻的矽晶片在SEM 5k倍觀察金字塔照片

33 圖21-2. (a) 經過SF6蝕刻的矽晶片在SEM 10k倍觀察金字塔之間照片

33 圖21-2. (b) 經過SF6蝕刻的矽晶片在SEM 50k倍觀察金字塔之間照片

34 圖21-3. 經過SF6蝕刻的矽晶片在SEM 100k倍觀察金字塔照片

34 圖22-1. (a) 經過SF6蝕刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM 5k倍觀察矽晶片表面照

iii 中文摘要

v 謹謝

vii 圖目錄

xii 第

1 第二章 原理及製程介紹 2.1 太陽電池的起源

3 2.3 HIT太陽電池的結構與製作流程介紹

6 2.5 網印背面鋁電極

12 2.7 濺鍍抗反射導電膜與正面鋁電極

17 3.2 網印背面電極實驗

25 3.4 氢氣電漿實驗

38 3.6 氢氣電漿處理對效率關係實驗

53 附錄(A)

57 圖目錄 圖1. 元件結構示意圖

6 圖3. Texture後矽晶片

8 圖5. 網版印刷

10 圖7. 元

11 圖8. 氢離子束撞擊矽晶片示意圖

13 圖10. 氢氣電漿示意圖

18 圖12. 未經蝕刻的晶片在光學顯微鏡下觀察的結果

21 圖14. 網印背面電極流程圖

23 圖16. 網印後背面電極

26 圖18. H2流量與電導值關係

28 圖20-1. 未經過SF6蝕

30 圖20-2. 未經

31

片	35 圖22-1. (b)經過SF6蝕刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM 10k倍觀察金字塔
照片	36 圖22-2. (a)經過SF6蝕刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM 30k倍觀察
金字塔照片	36 圖22-2. (b) 經過SF6蝕刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM 50k
倍觀察金字塔照片	37 圖22-3. 經過SF6蝕刻及氫氣電漿處理的矽晶片在SEM
100k倍金字塔照片	37 圖23. 基板溫度與RS關係圖
	39 圖24. 基板溫度與薄膜穿透度關係圖
電阻係數的影響	41 圖26.不同鍍膜溫度及時間對ITO薄膜穿透度的影響
的Transmittance比較	42 圖28. 沒有製作ITO的矽基板
池	43 圖30.不銹鋼遮罩
氣電漿處理的元件I-V圖	45 圖32. 未做氫氣電漿處理的元件I-V圖
一次田口SN比因子輔助圖	47 圖34. 第一次田口實驗中第5個實驗元件I-V圖
圖37. 第二次田口實驗分析後最佳化實驗I-V圖	49 圖36.第二次田口實驗中第6個實驗元件I-V圖
48 表2. 第一次田口條件完成後測量出的效率	53 表目錄 表1. 第一次田口條件表
51 表4. 第二次田口條件完成後測量出的效率	48 表3. 第二次田口條件表
	51

REFERENCES

- [1] Zweibel, K., Harnessing solar cell-The photovoltaics challenge. 1990.
- [2] 郭明村, "薄膜太陽電池發展現況", 工業材料雜誌 203期 92年11月, p138.
- [3] 林延儒, "奈米太陽電池", 工業材料雜誌 203期 92年11月, p143.
- [4] 黃建昇, "結晶矽太陽電池發展現況", 工業材料雜誌 203期 92年11月, p150.
- [5] W. Fuhs et al., "Heterojunctions of Amorphous Silicon & Silicon Single Crystals", Int. Conf. Tetrahedrally Bonded Semiconductors, Yorktown Heights, N.Y. (1974), pp. 345-350.
- [6] Gibbons, James F., "Amorphous solar cells", USA Patent No.:4270018, May 26, 1981 [7] Gibbons, James F., "solar cells and method", USA Patent No.:4434318, Feb 28, 1984 [8] N. Terada and Y. Harada, US Patent (No. 5,648,675) Jul. 15, 1997.
- [9] M. Iwamoto, K. Minami and T. Yoshihiko, US Patent (No. 5,066,340) Nov. 19, 1991.
- [10] A. F. Morral and P. R. Cabarrocas, J. Non-Cryst. Solids, 299-302 (2002) pp. 196-200.
- [11] Adams, W.G., and R.E.Day, Proc. R. Soc., 1877.A25:p. 133.a [12] Chapin, D. M., Fuller, C.S and Pearson, G. L., A new p-n junction photocell for converting solar radiation into electrical power, J. App.: Phys. 25,1954: 676-677 [13] Peter Van Zant, "Microchip Fabrication : a practical guide to semiconductor processing", 4th ed, Microchip Fabrication.
- [14] M. Quik, J. Serda, "Semiconductor Manufacturing Technology" [15] Hong-Yih Tseng, Sien Chi, "Optical Element on Sin Membrane for Micro Optical Pickup Head", 光學工程, 第八十五期, 93.03, p59.
- [16] 林明獻, "矽晶圓性質之檢測", 矽晶圓半導體材料技術, 全華科技圖書, P7-6.
- [17] A. Fontcuberta I Morral, P. Roca I Cabarrocas, "Etching and hydrogen diffusion mechanisms during a hydrogen plasma treatment of silicon thin films", Journal of Non-Crystalline Solids, 299-302(2002) 196-200 [18] W.R. Runyan, and T. J. Shaffner, "Semiconductor Measurement & Instrumenmts", The Mc Graw-Hill Companies, Inc., International Edition 1998.
- [19] 林明獻, "矽晶圓性質之檢測", 矽晶圓半導體材料技術, 全華科技圖書, P7-57.